

- 10H00 - Introduction
- 10H10 - Données générales des runs 2010 et évolution
- 10H30 - austriamicrosystems : ▶ procédés offerts
▶ high voltage CMOS, HV flash EEPROM, CMOS Opto
▶ 0.18 μ HV CMOS
▶ réalisations en 2010
- 10H50 - STMicroelectronics : ▶ procédés offerts
▶ réalisations en 2010
- 11H10 - Microsystèmes : ▶ MEMSCAP
▶ 0.35 μ CMOS Bulk Micromachining
▶ Sandia
▶ réalisations en 2010
- 11H35 - Packaging
- 12H00 - Gestion et administration des runs
- 12H10 - Vérifications avant fabrication
- 12H20 - Design kits, bibliothèques et IPs
- 12H30 - Distribution de design kits et de logiciels CAO
- 12H45 - CIM'Alpes, offre d'utilisation de logiciels de CAO, Laurent FESQUET, CIME-NANOTECH
- 13H00 *Pause déjeuner*
- 13H45 - ARM, activités 2010, présentation par Eric LALARDIE, ARM
- 14H10 - EVATRONIX, activités 2010, présentation par Michal JEDRAK, EVATRONIX
- 14H30 - Développements du service en 2011 :
- 14H30 ▶ CMOS-magnétique
- 14H45 ▶ Technologie 3D-IC de TEZZARON
- 15H10 ▶ Technologie Fully-Depleted SOI du CEA-LETI, Carlo REITA, CEA-LETI
- 15H30 ▶ Technologie AsGa TQP15 de TRIQUINT, Sylvain DUMAY, TRIQUINT
- 15H50 - Autres développements du service en 2011
- Distributeurs et coopérations avec d'autres services
 - Budget
 - Questions diverses